

芯片需要做哪些pre-con可靠性测试项目

产品名称	芯片需要做哪些pre-con可靠性测试项目
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司-检测部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂2层
联系电话	13378656621 13378656621

产品详情

芯片可靠性测试主要分为环境试验和寿命试验两个大项，其中环境试验中包含了机械试验（振动试验、冲击试验、离心加速试验、引出线抗拉强度试验和引出线弯曲试验）、引出线易焊性试验、温度试验（低温、高温和温度交变试验）、湿热试验（恒定湿度和交变湿热）、特殊试验（盐雾试验、霉菌试验、低气压试验、静电耐受力试验、超高真空试验和核辐射试验）；而寿命试验包含了长期寿命试验（长期储存寿命和长期工作寿命）和加速寿命试验（恒定应力加速寿命、步进应力加速寿命和序进应力加速寿命），其中可以有选择的做其中一些。

一般来说，可靠度是产品以标准技术条件下，在特定时间内展现特定功能的能力，可靠度是量测失效的可能性，失效的比率，以及产品的可修护性。根据产品的技术规范以及客户的要求，我们可以执行mil-std,jedec,iec,jesd,aec,andeia等不同规范的可靠度的测试。

测试机台种类 高温贮存试验(htst,hightemperaturestoragetest)

低温贮存试验(ltst,lowtemperaturestoragetest)

温湿度贮存试验(thst,temperature&humiditystoragetest)

温湿度偏压试验(thb,temperature&humiditywithbiastest)

高温水蒸汽压力试验(pressurecookertest(pct/ub-hast)

高加速温湿度试验(hast,highlyacceleratedstresstest)

温度循环试验(tct,temperaturecyclingtest)

温度冲击试验(tst,thermalshocktest)

高温寿命试验(htol,hightemperatureoperationlifetest)

高温偏压试验(blt,biaslifetest)

回焊炉(reflowtest)